



Co-funded by
the European Union



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia



CONTRATO DE SUMINISTRO DE UN EQUIPO PARA EL MECANIZADO LASER DE SUSTRATOS PARA RADIOFRECUENCIA, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA – FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA - NEXT GENERATION EU A TRAVÉS DEL PROGRAMA «UNICO CHIPS JU – LÍNEA PILOTO DE FOTÓNICA INTEGRADA», Y LOS PROGRAMAS HORIZONTE EUROPA Y EUROPA DIGITAL, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

Número de expediente: L07-2026

Por la presente comunicación, se hacen las siguientes correcciones en el pliego de cláusulas técnicas particulares de la licitación:

- **Pliego de Cláusulas Técnicas Particulares:**

1. Se corrigen las dimensiones del área de trabajo mínima del equipamiento, así como la relación de aspecto mínima del equipo de metalizado de vías pasantes incluidos en el apartado 3.1. Este apartado corregido queda como sigue:

3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONSTRUCTIVAS.

El equipo cumplirá con los siguientes requisitos:

Área de trabajo

- *Area de trabajo de mínimo 305 x 229 x 7 mm.*
- *Mesa con succión por vacío para fijación del sustrato.*
- *Mesa con desplazamiento XY.*
- *Sistema de aspiración y filtrado para residuos generados en el proceso de materiales.*

Capacidades del equipo

- *Capacidad de remoción de capas superficiales conductoras afectando en la menor de las medidas al sustrato, ya sea vía software, hardware o una combinación de ambas.*
- *Ajuste del enfoque del láser automático*

Capacidades de mecanizado y fuente láser.

- *Fuente laser de tipo pulsado.*
- *Duración del pulso no superior a 2 picosegundos.*
- *La potencia del laser no debe ser inferior a 8W (vatios).*
- *Fuente Laser con longitud de onda de emisión en el rango del verde (495-570 nanómetros)*
- *Rango de frecuencias de trabajo programable de la fuente laser de 50 a 500KHz.*



Co-funded by
the European Union



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia



- *Precisión de posicionamiento de mínimo ± 5 .*
- *Capacidad de hacer vías pasantes ("through-hole vías") en los sustratos.*
- *Diámetro del láser enfocado no superior a 15 micras (μm).*

Sustratos

- *Capacidad de procesar materiales con capas conductivas de hasta 35 micras (μm).*
- *Procesado de materiales poliméricos.*
- *Procesado de vidrios, cuarzo y borosilicatos.*
- *Procesado de cerámicas sin producir micro fisuras ni decoloración.*

Software

- *El software de control deberá ser suministrado con librerías de datos de ajustes para diferentes materiales. Deberá contar además con optimización del borde de escaneo para mejorar la precisión del contorno y reducir el impacto en los materiales.*
- *El software deberá permitir el reconocimiento de fiduciales de forma libre para alineamiento.*
- *El software suministrado con el equipo deberá permitir visualizar el impacto de los parámetros del láser antes de la ejecución para facilitar la precisión de los ajustes.*

Equipo de metalizado de vías pasantes ("through-hole vías") en PCBs mediante proceso galvánico.

- *Equipo que permita el metalizado de las interconexiones (vías pasantes) creadas en el sustrato tras el proceso de mecanizado laser.*
- *Metalizado rápido de taladros en todos los materiales comunes de placas de circuitos.*
- *Diámetro mínimo de Taladro de 0.2mm*
- *Debe asegurar una geometría mínima ('aspect ratio') de 1:8*

Con esta configuración mínima propuesta el equipo deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- *Especificaciones medioambientales: el nivel de ruido debe mantenerse en unos niveles que no provoquen daños auditivos ($< 70\text{dB}$).*
- *El equipo deberá ser suministrado con todas las herramientas necesarias para realizar los ajustes necesarios en el uso diario del equipo.*
- *El equipo deberá ser suministrado con todos los elementos de seguridad necesarios para su operación sin riesgo.*

De acuerdo a lo establecido en el artículo 136.2 de la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, de 8 de noviembre, **SI** resulta aplicable la ampliación del plazo inicial de presentación de ofertas y solicitudes de participación dado que la modificación se considera significativa al tratarse de información asociada a elementos referidos en los pliegos y documentos de contratación necesarios para la elaboración de la oferta económica de los licitadores, por lo que se procede a la publicación de la presente corrección en el Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, así como el Pliego de Cláusulas Técnicas Particulares con la corrección aplicada, ampliándose el plazo de presentación de solicitudes establecido al inicio en 35 días naturales a contar a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la presente corrección.